

Title (en)

Bath for electroplating silver-palladium alloys.

Title (de)

Bad zum elektrolytischen Abscheiden von Silber-Palladium-Legierungen.

Title (fr)

Bain de dépôt électrolytique des alliages en argent-palladium.

Publication

EP 0239876 A1 19871007 (DE)

Application

EP 87103932 A 19870318

Priority

DE 3609309 A 19860320

Abstract (en)

1. Aqueous, alkaline, cyanide free and ammonia free bath for the electrolytical deposition of silver-palladium alloys from soluble complex compounds of silver-succinimide derivates and from soluble palladium compounds characterized in that it contains the palladium in form of a diphosphate and/or a polyphosphate of palladium.

Abstract (de)

Es wird ein wässriges, schwach alkalisches, cyanid- und ammoniakfreies Bad zum elektrolytischen Abscheiden von Silber-Palladium-Legierungen beschrieben, welches das Silber als Silber-Succinimidkomplex und das Palladium als Palladiumdiphosphat und /oder als Palladiumpolyphosphat enthält.

IPC 1-7

C25D 3/56; **C25D 3/64**

IPC 8 full level

C25D 3/56 (2006.01); **C25D 3/64** (2006.01)

CPC (source: EP)

C25D 3/56 (2013.01); **C25D 3/64** (2013.01)

Citation (search report)

- [YD] FR 2343062 A2 19770930 - TECHNIC [US]
- [A] FR 2496127 A1 19820618 - HOOKER CHEMICALS PLASTICS CORP [US]
- [A] GB 2046794 A 19801119 - ENGELHARD MIN & CHEM
- [Y] CHEMICAL ABSTRACTS, Band 97, Nr. 12, September 1982, Seite 570, Zusammenfassung Nr. 100709j, Columbus, Ohio, US; & JP-A-82 76 196 (KUMAMOTO PREFECTURE) 13-05-1982

Cited by

DE4412253A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB LI NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0239876 A1 19871007; **EP 0239876 B1 19900905**; DE 3609309 A1 19870924; DE 3609309 C2 19880601; DE 3764685 D1 19901011

DOCDB simple family (application)

EP 87103932 A 19870318; DE 3609309 A 19860320; DE 3764685 T 19870318